

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 106 (1988)  
**Heft:** 37

## Vereinsnachrichten

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein  
Société suisse des ingénieurs et des architectes  
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

## Böden und Bodenbeläge

### EMPA/SIA-Studientagung

EMPA und SIA organisieren gemeinsam am Mittwoch, 14. September 1988, 9.30 bis 17.15 Uhr, eine Studientagung, die sich an Architekten, Bauingenieure und Unternehmer richtet. Sie findet statt an der ETH Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 101, Zürich, Hörsaal E 7.

#### Ziel:

- Aufzeigen der Probleme, die bei Böden und Bodenbelägen auftreten
- Präsentation von fachgerechten Lösungen
- Einführung in die neuen SIA-Normen in diesem Bereich. Erläuterungen der darin enthaltenen Erfahrungen aus der Praxis.

#### Programm:

9.30: Begrüssung (U. Meier); Bauphysik der Bodenkonstruktionen (R. Sagelsdorff); Akustik (G. Stupp); Elektrostatik, Erdableitung (Dr. T. Zimmerli); Bodenheizungssysteme (E. Ballmer); Kaffeepause; Die neuen SIA-Normen (P. Ehrensperger); Schwimmende Unterlagsböden (H. Epple); Bodenbeläge aus Textilien (E. Martin); Diskussion; Mittagspause. 13.45: Konstruktion und Durchbildung von Bodenplatten (H. Epple); Bodenbeläge aus Hartbeton und magnesiagebundene Bodenbeläge; Böden aus Vakuumbeton (R. Liniger); Bodenbeläge aus PVC und Linoleum (Dr. P. Pagani); Kaffeepause; Kunstharzbodenbeläge (C. Schellenberg); Bodenbeläge aus Holz (M. Mayer); Platten- und Natursteinbeläge (K. Kolonko); Diskussion. 17.15: Ende der Tagung

#### Referenten:

E. Ballmer, Heizungingenieur SWKI, Techn. Leiter, Gebr. Tobler AG, Urdorf; P. Ehrensperger, Architekt ETH/SIA, Inhaber Architekturbüro, Bern; K. Epple, Bauingenieur ETH, Abteilungsleiter, Gruner AG, Basel; K. Kolonko, Oberingenieur, SKS Technik Säure- und Korrosionsschutz GmbH, Göppingen BRD; R. Liniger, Vizedirektor, Euböolithwerke AG, Olten; E. Martin, Physiker ETH, Sektionschef, EMPA, St. Gallen; M. Mayer, Ingenieur FH, Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen; U. Meier, Bauingenieur ETH, Vizedirektor EMPA, Dübendorf; Dr. P. Pagani, Ingenieurchemiker ETH, Entwicklungsleiter, Forbo-Giubiasco SA, Giubiasco; R. Sagelsdorff, Bauingenieur ETH/SIA, Sektionschef Abt. Bauphysik, EMPA, Dübendorf; C. Schellenberg, Chemiker HTL, Geschäftsführer, Radix AG, Steinebrunn; G. Stupp, Maschineningenieur HTL/SIA, Leiter Gruppe Bauakustik, EMPA, Dübendorf; Dr. T. Zimmerli, Sektionschef Abt. Physik, EMPA, St. Gallen.

#### Tagungsbeitrag:

Mitglieder SIA Fr. 160.-, Nichtmitglieder Fr. 200.-. Im Tagungsbeitrag sind inbegriffen: Dokumentationsband SIA D 032, Böden und Bodenbeläge. Mittagessen in der Mensa. Pausenkaffee.

Bei Rückzug einer Anmeldung wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 50.- erhoben. Im Verhinderungsfall muss der Teilnehmerausweis bis spätestens 13. September 1988 an das SIA-Generalsekretariat zurückgeschickt werden. Andernfalls wird der ganze Tagungsbeitrag verrechnet.

Wir bitten Sie, den Tagungsbeitrag nach Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung auf PC 80-5594-0 einzuzahlen.

#### Tagungsunterlagen:

Als Unterlage zur Tagung dient der Dokumentationsband SIA D 032, Böden und Bodenbeläge, der jedem Teilnehmer an der Tagung abgegeben wird und im Tagungsbeitrag inbegriffen ist.

#### Teilnehmerausweis:

Der Teilnehmerausweis wird zusammen mit der Anmeldebestätigung und Rechnung zugesandt.

#### Auskunft und Anmeldung:

SIA-Generalsekretariat, Postfach, 8039 Zürich, Tel. 01/201 15 70, Telefax 01/201 63 35.

## Informatik im Bauwesen

### Neuaufgaben rechtzeitig auf die Swissdata

Der SIA hat seine wichtigsten Publikationen auf dem Gebiet der Einführung in die EDV und seine Kataloge und Übersichtswerke in der Reihe «Informatik im Bauwesen» zusammengefasst. Die Publikationen werden regelmässig auf den neuesten Stand gebracht und neu aufgelegt. Rechtzeitig auf die Swissdata 1988 liegen die neuesten Ausgaben vor.

### D 501 Einführung der EDV im Projektierungsbüro

Definiert die Grundbegriffe der EDV und gibt Hinweise und Ratschläge für die Evaluation bei der Einführung der EDV im Architektur- und Ingenieurbüro. Zweisprachig, 28 Seiten.

### D 502 SIA Systemkatalog Administration

Aktuelle Übersichtstabellen über Soft- und Hardware mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Organisation und Administration des Projektierungsbüros sowie mit Programmen für den Bauingenieur. Enthält Kostangaben. Dient für die Vorauswahl bei der Einführung der EDV als Ergänzung zum Band D 501. Detaillierte Angaben über die Programme sind im Software-Katalog enthalten. Zweisprachig, 32 Seiten, 5 Falttabellen.

### D 503 SIA Software-Katalog

Jährliche Ausgabe. Als zentraler Teil der Publikationsreihe Informatik orientiert er die planenden Architekten und Ingenieure umfassend über die auf dem Schweizer Markt angebotene Software für das Bauwesen. Er enthält die wesentlichen Angaben zu mehr als 250 Programmen, die auf 11 Einsatzbe-

reiche verteilt sind. Er wird durch Anbieter- und Programmverzeichnisse vervollständigt. Zweisprachig (erscheint seit 1981), 182 Seiten.

### D 504 SIA Systemkatalog CAD

Jährliche Ausgabe. Detaillierte Beschreibung der in der Schweiz erhältlichen CAD-Systeme für das Bauwesen mit neutralem Testbericht. Zweisprachig, 156 Seiten.

## Fachgruppen

### FVC: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Mechanischen und Thermischen Verfahrenstechnik

Am Donnerstag, dem 15. September 1988, findet in Basel, Kongresszentrum EWTCC (Schweiz. Mustermesse), Messeplatz 22, Seminarraum «Sydney», die diesjährige gemeinsame Tagung der beiden Arbeitsgruppen «Mechanische Verfahrenstechnik» und «Thermische Verfahrenstechnik» statt. Diese Tagung wird verbunden mit der Generalversammlung der SIA-Fachgruppe für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurtechnik (FVC) sowie der SATW-Jahrestagung 1988, die am gleichen Ort um 17.30 Uhr beginnt und am 16.9. mit dem SATW-Symposium über «Biotechnologie, eine Herausforderung für den Ingenieur» fortgesetzt wird.

#### Programm:

09.00 Uhr: Begrüssung durch die Arbeitsgruppenleiter (Prof. F. Widmer, Dr. D. Hody). Vorträge: Dr. L. Pedrocchi, Lonza AG, Basel: Emulsionsherstellung im turbulenten Scherspalt; B. Kegel, dipl. Ing. ETH, Gebrüder Sulzer AG Winterthur: Mikroverkapselung durch Hydroprillieren. 10.15 Uhr: Pause. 10.30 Uhr: Vorträge: M. Hofer, dipl. Ing. ETH, Institut für Verfahrenstechnik und Kältetechnik/Paul Scherrer Institut, Villigen: On line - Massenseparation als Produktionsverfahren für hochreine Radionuklide; S. Egli, dipl. Ing. ETH, Institut für Verfahrenstechnik und Kältetechnik, Zürich: Entwicklung und Charakterisierung von Membranen für die Nano- und Ultrafiltration. Dr. R. Rutte, Sandoz AG, Basel: Kontinuierliche trägerfreie Elektrophorese - ein Reinigungsverfahren für Produkte hoher Wertschöpfung. 12.00 Uhr: Ende. 15.00 Uhr: Generalversammlung der SIA-FVC gemäss separater Einladung.

#### Kosten:

Fr. 30.- für FVC-Mitglieder, Fr. 30.- für Nichtmitglieder der FVC

#### Anmeldung:

SIA-Generalsekretariat, Frau S. Salamon, Selnastrasse 16, 8039 Zürich, Tel. 01/201 15 70, Telefax 01/201 63 35, und an der Tageskasse.